

半导体

荷兰对光刻机出口进一步限制，国产化亟待加速

在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府正准备对半导体设备实施新的出口限制。当地时间3月8日，荷兰贸易部长列斯杰·施赖纳马赫尔（Liesje Schreinemacher）在致立法者的一封信中表示，荷兰政府考虑了“技术发展和地缘政治背景”，准备对半导体设备实施新的出口限制，这些规定预计将在夏季之前公布。她在信中没有具体提及中国和荷兰半导体设备主要供应商ASML，但指出其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术。“出于国家和国际安全考虑，有必要尽快控制这项技术。”

ASML针对上述出口限制发布声明，表示额外的出口管制并不涉及所有浸没式光刻机，而只涉及所谓的“最先进的”设备。ASML提到，这些控制措施需要时间才能转化为立法并生效，公司预计这些措施不会对此前发布的2023年财务展望产生重大影响。ASML强调，额外的出口管制并不涉及所有浸没式光刻机，而只涉及所谓的“最先进的”设备。尽管ASML尚未收到有关“最先进”确切定义的更多细节，但ASML将其解释为“关键沉浸”（critical immersion），ASML将其定义为TWINSCAN NXT：2000i和之后推出的浸没式系统。此外，ASML指出，制程位于成熟节点的客户仍旧可以使用不太先进的浸没式光刻机。

光刻机是制造芯片的核心装备，制造难度极大，国产光刻机仍较为落后。目前高端光刻机制造领域，全球只有少数几家公司能掌握，那就是荷兰的ASML，日本的尼康和佳能。中低端领域，国产光刻机龙头上海微电子（SMEE）能够触及。目前，上海微电子已经能实现90nm量产（600系列光刻机），正在攻克28nm光刻机，与ASML的技术实力仍有较大差距，国产光刻机亟待突破。

在光刻机国产化道路上，零部件也是不可忽视的重要环节。在光刻机零部件中，KBBF晶体主要用来制造深紫外激光器，而光刻机就是深紫外激光器的高端应用市场。2013年，我国研制的全球首个深紫外固态激光器通过验收，成为当时全球唯一能够制造实用化深紫外全固态激光器的国家，为国产DUV光刻机行业发展奠定坚实基础。而光学透镜则是保证光刻机高成像质量的关键组件，我国的茂莱光学的DUV光学透镜已经在给上海微电子供货，助力我国半导体光刻机国产化。

建议关注：

- 1) **半导体零部件：**正帆科技（天风机械团队联合覆盖）/江丰电子/茂莱光学/新莱应材（天风机械团队覆盖）/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机（天风机械团队覆盖）/国机精工（天风机械团队覆盖）;
- 2) **半导体材料设备：**雅克科技/沪硅产业/华峰测控（天风机械团队覆盖）/上海新阳/中微公司/精测电子（天风机械团队联合覆盖）/长川科技（天风机械团队覆盖）/鼎龙股份（天风化工团队联合覆盖）/安集科技/拓荆科技（天风机械团队联合覆盖）/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体（天风化工团队覆盖）/凯美特气/杭氧股份（天风机械团队覆盖）/和远气体/华懋科技；
- 3) **半导体设计：**江波龙（天风计算机团队联合覆盖）/纳芯微/圣邦股份/晶晨股份/斯达半导/宏微科技/东微半导/瑞芯微/思瑞浦/中颖电子/澜起科技/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/龙芯中科/海光信息（天风计算机团队覆盖）；
- 4) **IDM：**闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；
- 5) **代工封测：**华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；
- 6) **卫星产业链：**声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通

风险提示：宏观不确定性，疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期。

证券研究报告
2023年03月14日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者

潘暕 分析师
SAC执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

程如莹 分析师
SAC执业证书编号：S1110521110002
chengruying@tfzq.com

骆奕扬 分析师
SAC执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:政策预期升温，关注国产化，周期复苏，与新技术》
2023-03-06
- 2 《半导体-行业研究周报:23Q1库存持续去化，基本面或加速触底》
2023-02-27
- 3 《半导体-行业研究周报:22年12月国产半导体设备中标数同比+185%，关注ChatGPT领域及周期复苏》
2023-02-19

内容目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. 每周谈-荷兰对光刻机出口进一步限制，国产化亟待加速 | 3 |
| 1.1. ASML 发布有关光刻机出口限制的声明 | 3 |
| 1.2. 目前国内大部分产线不受影响，光刻机国产化亟待加速 | 4 |
| 2. 本周半导体行情回顾 | 5 |
| 3. 本周重点公司公告 | 7 |
| 4. 半导体重点新闻 | 9 |
| 5. 风险提示 | 12 |

图表目录

| | |
|----------------------------------|---|
| 图 1：ASML 2022 年产品结构 | 3 |
| 图 2：ASML 浸没式光刻机产品 | 3 |
| 图 3：上海微电子 600 系列光刻机及主要技术参数 | 4 |
| 图 4：茂莱光学半导体光刻机用 DUV 光学透镜 | 5 |
| 图 5：本周 A 股各行业行情对比（%） | 6 |
| 图 6：本周子板块涨跌幅（%） | 6 |
| 图 7：半导体子板块估值与业绩增速预期 | 6 |
| 表 1：本周半导体行情与主要指数对比 | 5 |
| 表 2：本周涨跌前 10 半导体个股 | 6 |

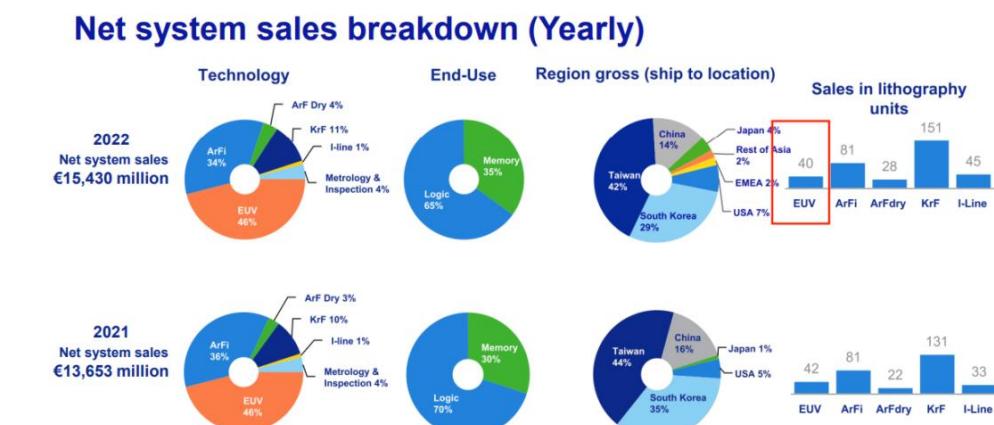
1. 每周谈-荷兰对光刻机出口进一步限制，国产化亟待加速

1.1. ASML 发布有关光刻机出口限制的声明

在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下，荷兰政府正准备对半导体设备实施新的出口限制。当地时间 3 月 8 日，荷兰贸易部长列斯杰 · 施赖纳马赫尔（ Liesje Schreinemacher ）在致立法者的一封信中表示，荷兰政府考虑了“技术发展和地缘政治背景”，准备对半导体设备实施新的出口限制，这些规定预计将在夏季之前公布。她在信中没有具体提及中国和荷兰半导体设备主要供应商 ASML，但指出其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术。“出于国家和国际安全考虑，有必要尽快控制这项技术。”

ASML 营收或受影响。根据 ASML 公司 2022 年财报，2022 年公司共出货 345 台光刻系统，其中有 81 台浸没式 DUV 光刻机（ ArFi ），占比为 23% 。所有产品中， 42% 销往中国台湾， 29% 销往韩国， 14% 销往中国大陆，销往美国的只有 7% 。出口受到限制， ASML 收入或将受到干扰。

图 1：ASML 2022 年产品结构



资料来源： ASML 财报，天风证券研究所

ASML 针对上述出口限制发布声明，表示额外的出口管制并不涉及所有浸没式光刻机，而只涉及所谓的“最先进的”设备。 ASML 提到，这些控制措施需要时间才能转化为立法并生效，公司预计这些措施不会对此前发布的 2023 年财务展望产生重大影响。 ASML 强调，额外的出口管制并不涉及所有浸没式光刻机，而只涉及所谓的“最先进的”设备。尽管 ASML 尚未收到有关“最先进”确切定义的更多细节，但 ASML 将其解释为“关键沉浸”（ critical immersion ）， ASML 将其定义为 TWINSCAN NXT: 2000i 和之后推出的浸没式系统。根据官网， ASML 推出的浸润式 DUV 有三款，依次是 TWINSCAN NXT:1980Di 、 TWINSCAN NXT: 2000i 、 TWINSCAN NXT: 2050i 。依照 ASML 所说，受限制的只有后两款 2000i 和 2050i 。根据官网， 2000i 和 2050i 都可用于高级逻辑芯片和 DRAM 节点的大批量制造。此外， ASML 指出，制程位于成熟节点的客户仍旧可以使用不太先进的浸没式光刻机。

图 2：ASML 浸没式光刻机产品



资料来源：ASML 官网，天风证券研究所

就上述荷兰方面行为，3月9日，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中方注意到有关报道，对荷方以行政手段干预限制中荷企业正常经贸往来的行为表示不满，已向荷方提出交涉。希望荷方秉持客观公正立场和市场原则，尊重契约精神，不滥用出口管制措施，维护国际产业链供应链稳定和自由开放的国际贸易秩序，维护中荷两国和双方企业共同利益。

1.2. 目前国内大部分产线不受影响，光刻机国产化亟待加速

目前国内大部分产线不受荷兰光刻机出口限制影响。在中国与 ASML 有直接供应关系的企业主要是芯片制造商，有中芯国际、华力半导体、长江存储等中国企业，还有三星的西安工厂、台积电南京厂、英特尔大连厂、无锡 SK 海力士厂等外资企业。根据经济观察报的报道，目前全国各地建设的半导体厂约有数百家，除了头部的半导体厂，真正能用上浸润式 DUV 的工厂并不多，整体的建设处于尚未形成规模效益的初期阶段，月产能达到数十万片晶圆的产线是非常少的。同时，这些产线不涉及先进芯片，主要用于生产技术相对成熟的芯片，如功率器件等。

光刻机是制造芯片的核心装备，制造难度极大，国产光刻机仍较为落后。目前高端光刻机制造领域，全球只有少数几家公司能掌握，那就是荷兰的 ASML，日本的尼康和佳能。中低端领域，国产光刻机龙头上海微电子（SMEE）能够触及。目前，上海微电子已经能实现 90nm 量产（600 系列光刻机），正在攻克 28nm 光刻机，与 ASML 的技术实力仍有较大差距，国产光刻机亟待突破。

图 3：上海微电子 600 系列光刻机及主要技术参数

600系列光刻机 —— IC前道制造



SSX600系列步进扫描投影光刻机采用四倍缩小倍率的投影物镜、工艺自适应调焦调平技术，以及高速高精的自减振六自由度工件台掩模台技术，可满足IC前道制造90nm、110nm、280nm关键层和非关键层的光刻工艺需求。该设备可用于8寸线或12寸线的大规模工业生产。

■ 主要技术参数

| 型号 | SSA600/20 | SSC600/10 | SSB600/10 |
|------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 分辨率 | 90nm | 110nm | 280nm |
| 曝光光源 | ArF excimer laser | KrF excimer laser | i-line mercury lamp |
| 镜头倍率 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 硅片尺寸 | 200mm或300mm | 200mm或300mm | 200mm或300mm |

资料来源：上海微电子官网，天风证券研究所

在光刻机国产化道路上，零部件也是不可忽视的重要环节。在光刻机零部件中，KBBF 晶体主要用来制造深紫外激光器，而光刻机就是深紫外激光器的高端应用市场。2013 年，我国研制的全球首个深紫外固态激光器通过验收，成为当时全球唯一能够制造实用化深紫外全固态激光器的国家，为国产 DUV 光刻机行业发展奠定坚实基础。而光学透镜则是保证光刻机高成像质量的关键组件，我国的茂莱光学的 DUV 光学透镜已经在给上海微电子供货，助力我国半导体光刻机国产化。

图 4：茂莱光学半导体光刻机用 DUV 光学透镜

| 产品名称 | 产品图示 | 产品介绍 | 应用图示 | 应用领域简介 |
|--------------|---|---|--|---------------------------------------|
| 半导体 DUV 光学透镜 |  | 该产品选用高纯度石英、CaF2 材料，经由高质量抛光、半导体紫外光谱段镀膜后可实现高面型与表面光洁度，口径在 100mm-300mm，达到深紫外波段要求。 |  | 该产品用于光刻机光学系统照明、曝光模块，是保证光刻机高成像质量的关键组件。 |

资料来源：茂莱光学招股书，天风证券研究所

2. 本周半导体行情回顾

本周半导体行情跑赢大部分指数。本周申万半导体行业指数下跌 2.75%，同期创业板指数下跌 2.15%，上证综指下跌 2.95%，深证综指下跌 3.45%，中小板指数下跌 3.76%，万得全 A 下跌 3.17%。半导体行业指数跑赢大部分指数。

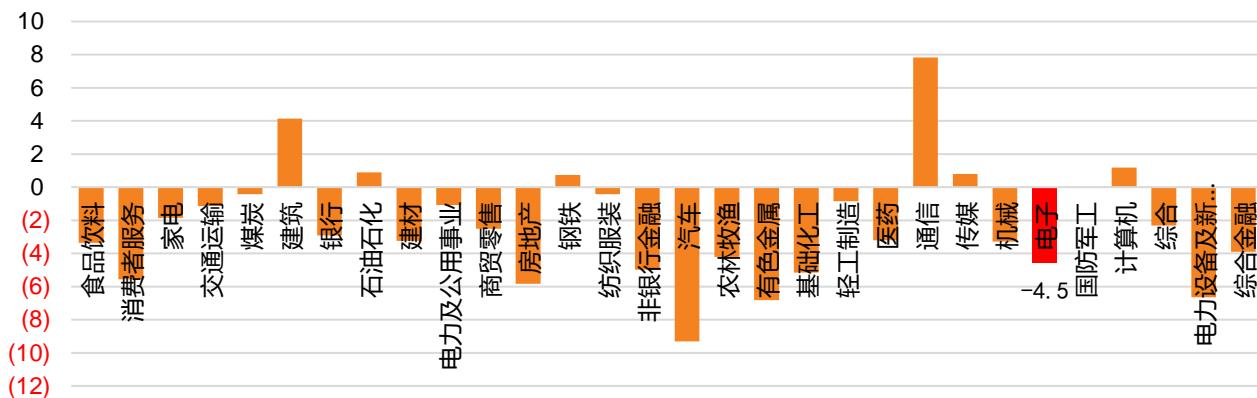
表 1：本周半导体行情与主要指数对比

| | 本周涨跌幅% | 半导体行业相对涨跌幅 (%) |
|--------|--------|----------------|
| 创业板指数 | -2.15 | -0.60 |
| 上证综合指数 | -2.95 | 0.20 |
| 深证综合指数 | -3.45 | 0.70 |
| 中小板指数 | -3.76 | 1.01 |

| | | |
|----------|-------|------|
| 万得全 A | -3.17 | 0.41 |
| 半导体 (申万) | -2.75 | 0.00 |

资料来源: Wind, 天风证券研究所

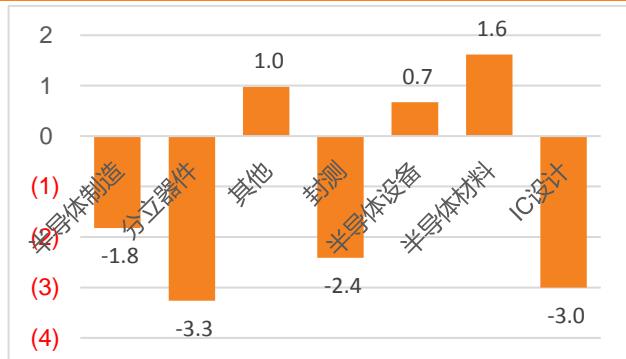
图 5: 本周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

半导体各细分板块大部分下跌。半导体细分板块中, 半导体材料板块本周上涨 1.6%, 半导体设备板块本周上涨 0.7%, 半导体制造板块本周下跌 1.8%, 封测板块本周下跌 2.4%, IC 设计板块本周下跌 3.0%, 分立器件板块本周下跌 3.3%, 其他板块本周上涨 1.0%。

图 6: 本周子板块涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 7: 半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源: Wind, 天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 容大感光、晶丰明源、强力新材、上海新阳、神工股份、台基股份、沪硅产业-U、正帆科技、南大光电、华特气体。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 创耀科技、复旦微电、通富微电、必创科技、紫光国微、炬芯科技、富瀚微、中环装备、瑞芯微、景嘉微。

表 2: 本周涨跌前 10 半导体个股

| 股票名称 | 涨跌幅 | 股票名称 | 涨跌幅 |
|--------|-----|------|-----|
| 容大感光 | 45% | 创耀科技 | -8% |
| 晶丰明源 | 11% | 复旦微电 | -8% |
| 强力新材 | 10% | 通富微电 | -7% |
| 上海新阳 | 8% | 必创科技 | -7% |
| 神工股份 | 7% | 紫光国微 | -6% |
| 台基股份 | 7% | 炬芯科技 | -6% |
| 沪硅产业-U | 7% | 富瀚微 | -6% |

| | | | |
|------|----|------|-----|
| 正帆科技 | 7% | 中环装备 | -6% |
| 南大光电 | 7% | 瑞芯微 | -5% |
| 华特气体 | 5% | 景嘉微 | -5% |

资料来源: Wind, 天风证券研究所

3. 本周重点公司公告

【汇成股份 688403.SH】

公司于 2023 年 2 月 28 日发布《合肥新汇成微电子股份有限公司 2022 年度业绩快报》。公告称，报告期内，公司实现营业总收入 93,965.28 万元，较上年同期增长 18.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,728.84 万元，较上年同期增长 26.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,624.51 万元，较上年同期增长 34.40%。报告期末，公司总资产为 319,577.28 万元，较报告期初增长 56.82%；归属于母公司的所有者权益为 290,376.93 万元，较报告期初增长 108.36%，归属于母公司所有者的每股净资产为 3.48 元，较报告期初增长 66.51%。

【大港股份 002077.SZ】

公司于 2023 年 1 月 20 日发布《江苏大港股份有限公司 2022 年度业绩预告》。公告称，报告期内，由于新冠疫情的综合影响，包括对消费电子市场的影响，对公司集成电路封装与测试业务产生了较大影响，营收规模与毛利率较上年均有所下降。报告期内，公司封装业务主体苏州科阳预计净利润较上年同期下降约 2,200 万元；测试业务主体上海旻艾预计净利润较上年同期下降约 1,400 万元。报告期内，公司出售天奈科技股份获取的收益对公司净利润的影响约为 2,200 万元（2021 年同期约为 9,700 万元），为非经常性损益。

【韦尔股份 603501.SH】

公司于 2023 年 1 月 14 日发布《上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年年度业绩预减公告》。公告称，预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 80,000.00 万元至 120,000.00 万元，与上年同期相比减少 327,618.75 万元至 367,618.75 万元，同比减少 73.19% 到 82.13%。扣除非经常性损益后，公司预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,000.00 万元至 13,500.00 万元，与上年同期相比减少 386,788.14 万元至 391,288.14 万元，同比减少 96.63% 到 97.75%。公司基于目前可获取的信息进行测算，预计 2022 年度计提的存货跌价准备为 134,000.00 万元至 149,000.00 万元，实际计提的存货跌价准备金额需以公司最终披露的经审计财务报表为准，这可能导致最终业绩与本次预计业绩存在差异。敬请投资者注意投资风险。

【芯原股份-U688521.SH】

公司于 2023 年 2 月 24 日发布《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告》。公告称，2022 年度，公司预计实现营业收入 26.79 亿元，同比增长 25.23%；营业收入的快速增长带动公司盈利能力持续提升，2022 年全年预计归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润均实现盈利。公司预计实现归属于母公司所有者的净利润 7,381.43 万元，同比增长 455.31%；预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为 1,329.06 万元，同比扭亏为盈。报告期末，公司财务状况良好，资产规模稳定增长，总资产额为 44.27 亿元，较报告期初增长 14.74%，归属于母公司所有者的所有者权益为 29.07 亿元，较报告期初增长 6.84%。公司报告期内营业利润预计同比增长 296.82%，利润总额预计同比增长 287.50%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 455.31%，基本每股收益预计同比增长 400.00%，上述变动主要由于公司报告期内保持了营业收入同比快速增长趋势，带动盈利能力不断提升，2022 年度全年预计归属于母公司所有

者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润均实现盈利。

【微导纳米 688147.SH】

公司于2023年2月28日发布《江苏微导纳米科技股份有限公司2022年度业绩快报公告》。公告称，报告期内，公司实现营业总收入68,451.19万元，较上年同期增加59.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6,013.19万元，较上年同期增加30.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,650.31万元，较上年同期减少0.70%。2022年12月公司首次公开发行股票对公司财务状况的影响较大，公司2022年末总资产为380,744.14万元，较期初增长180.60%；归属于母公司的所有者权益为196,877.06万元，较期初增长122.84%；归属于母公司所有者的每股净资产为4.33元，较期初增长100.46%。报告期内，公司下游行业市场规模增长、公司市场竞争力提升、产品应用领域扩展等因素导致订单和收入规模有所增长。公司一方面持续提升产品交付能力，满足客户快速增长的订单需求。另一方面，为应对业务增长的需求，扩充了管理、销售、研发团队，研发投入持续增加。

【晶晨股份 688099.SH】

公司于2023年2月25日发布《晶晨半导体（上海）股份有限公司2022年度业绩快报公告》。公告称，2022年全球经济受多重不利因素影响，下游多媒体终端产品需求受到一定抑制，市场景气度下降。面对不利环境，公司积极应对，一方面依托长期积累的优势产品线和优质客户群，保持了总体经营的韧性。另一方面公司提前应对，确保客户供应不受影响，保持了供应链的韧性。同时公司继续保持研发的高投入，积极拓展新的优势产品线。通过前述应对措施，公司一定程度降低了国内外不利因素的影响。报告期实现营业收入554,566.79万元，较上年同期增长16.09%。公司为研发驱动型公司，为了持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势，公司持续保持高强度的研发投入，本报告期内研发团队进一步扩大，研发投入持续增加。2022年度公司发生研发费用较上年同期增长30%以上，研发费用的增幅显著高于营业收入增幅。研发费用规模的增长部分抵消了收入增长对业绩的影响。受上述因素的综合影响，公司盈利规模较同期有一定波动。

【赛微微电 688325.SH】

公司于2023年2月28日发布《广东赛微微电子股份有限公司2022年度业绩快报公告》。公告称，公司2022年年度实现营业收入199,826,760.60元，较上年同期减少41.09%；实现营业利润34,800,650.71元，较上年同期减少61.73%；实现利润总额51,875,527.02元，较上年同期减少43.36%；实现归属于母公司所有者的净利润52,243,079.36元，较上年同期减少41.44%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,862,763.07元，较上年同期减少74.91%。公司营业收入下降主要系全球局势波动、疫情反复等因素影响，公司所处的下游行业尤其是消费电子市场需求持续不振，导致公司业务增长速度放缓，产品出货量减少。公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润下降主要系公司营业收入下降所致。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降主要系公司营业收入下降、本期收到大额政府补助所致。基本每股收益、加权平均净资产收益率下降主要系公司净利润下降、本期公司首次公开发行股份并在科创板上市新增了募集资金以及公司普通股股本所致。公司2022年末总资产为1,702,564,555.12元，较期初增加了478.08%；归属于母公司的所有者权益为1,647,275,749.57元，较期初增长了629.98%；公司股本80,000,000.00元，较期初增长了33.33%；归属于母公司所有者的每股净资产为20.59元，较期初增长了447.49%。上述指标增长主要系本期公司首次公开发行股份并在科创板上市新增了募集资金以及公司普通股股本所致。

【思科瑞 688053.SH】

公司于2023年2月28日发布《成都思科瑞微电子股份有限公司2022年度业绩快报公告》。公告称，报告期内，公司实现营业收入24,282.18万元，同比增长9.35%；实现归属于母公司所有者的净利润9,794.11万元，同比增长0.91%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,727.67万元，同比下降4.69%。报告期末，公司总资产为173,283.29万元，同比增长323.81%，归属于母公司的所有者权益为166,826.49万元，同比增长424.91%。报告期末，总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初分别增加323.81%、424.91%、33.33%、293.40%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股份并在科创板上市，收到募集资金使得公司总资产、净资产规模大幅增加。

【钜泉科技 688391.SH】

公司于2023年2月28日发布《钜泉光电科技（上海）股份有限公司2022年度业绩快报公告》。公告称，公司2022年度实现营业总收入70,990.47万元，同比增长42.17%；实现归属于母公司所有者的净利润20,004.37万元，同比增长97.28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,949.17万元，同比增长91.21%。2022年末，公司总资产218,715.20万元，同比增长420.13%；归属于母公司的所有者权益199,814.82万元，同比增长553.56%；归属于母公司所有者的每股净资产34.69元，同比增长389.97%。报告期内，受益于下游市场需求旺盛，集成电路产品业务整体发展良好。公司抓住行业机遇，积极开拓上下游市场和客户，努力克服疫情对产品生产和交付的影响，为业务持续增长提供了强有力的保障。2022年下半年，上游产能供给开始缓解，凭借着公司与上游供应商之间的良好合作关系，产能得到有效支持，推动了公司主营业务经营绩效和整体盈利能力的提升。公司营业总收入同比增长42.17%，营业利润同比增长85.33%，利润总额同比增长85.47%，归属于母公司所有者的净利润同比增长97.28%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长91.21%，基本每股收益同比增长81.70%，主要系报告期内下游市场需求旺盛，使得公司订单大幅增加，营业收入和净利润持续增长。总资产同比增长420.13%，归属于母公司的所有者权益同比增长553.56%，股本同比增长33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产同比增长389.97%，主要系报告期内完成首次公开发行股票，募集资金到账和净利润增加所致。

4. 半导体重点新闻

集邦：2023年SiC功率元件市场产值将突破22亿美元。据TrendForce集邦咨询研究显示，随着安森美(onsemi)、英飞凌(Infineon)等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元件市场产值达22.8亿美元，年成长41.4%。据TrendForce集邦咨询研究显示，随着安森美(onsemi)、英飞凌(Infineon)等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元件市场产值达22.8亿美元，年成长41.4%。（来源：中国半导体行业协会）

鸿海6000万美元增资越南子公司。据中国台湾媒体《经济日报》报道，鸿海集团扩大越南布局，昨(8)日增资两家越南子公司合计6000万美元。外界推测，本次增资主要是为了满足生产信息和通信技术(ICT)产品的运营资金需求，随着鸿海持续布局，越南已成为仅次于中国大陆的第二大生产基地。鸿海公告称，越南北江子公司富鸿精密元件(FUHONG PRECISION COMPONENT)取得FUYU PRECISION COMPONENT CO.,LTD.股权，交易金额3000万美元，主要作为子公司现金增资和长期投资；越南子公司富宁精密元件(FUNING PRECISION COMPONENT)也取得FUYU PRECISION COMPONENT股权，交易金额为3000万美元。鸿海2月中旬公告表示，斥资约1.48万亿越南盾(约4.83亿元人民币)，取得越南北江省土地。除了在越南扩大布局，知情人士称，鸿海正考虑在印度大举扩张，包括开设新厂、提高iPhone组装数量，进一步加速中国大陆以外的生产多样化。知情人士表示，鸿海计划2024年时将印度组装iPhone的年产量提高到2000万台，雇工人数将增加两倍至10万人。（来源：中国半导体行业协会）

1月份全球半导体销售额同比下降 18.5%。根据半导体行业协会(SIA)近日公布数据，全球半导体行业在2023年1月的销售额为413亿美元，这个数字比2022年12月的436亿美元减少了5.2%，比2022年1月的507亿美元减少了18.5%。根据半导体行业协会(SIA)近日公布数据，全球半导体行业在2023年1月的销售额为413亿美元，这个数字比2022年12月的436亿美元减少了5.2%，比2022年1月的507亿美元减少了18.5%。(来源：中国半导体行业协会)

SIA：1月份全球半导体销售额环比下降 5.2%。近日，半导体行业协会(SIA)发布报告称，2023年1月全球半导体销售额总计413亿美元，与2022年12月的436亿美元相比下降5.2%，与2022年1月的507亿美元相比下降18.5%。1月份欧洲(0.6%)的销售额环比略有增长，但日本(-2.1%)、亚太地区/所有其他(-2.7%)、美洲(-7.9%)和中国(-8.0%)有所下降。欧洲(0.9%)和日本(0.7%)的销售额同比略有增长，但美洲(-12.4%)、亚太地区/所有其他(-19.5%)和中国(-31.6%)的销售额同比下降。“尽管2022年的销售额创下历史新高，但全球半导体市场在今年下半年大幅降温，这一趋势在2023年的第一个月仍在持续。”SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，尽管目前出现短期周期性低迷，但由于芯片在推动当今和未来关键技术方面的作用越来越大，半导体市场的长期前景依然强劲。(来源：中国半导体行业协会)

预计2023年全球PC和平板出货量同比下降 11.2%。根据IDC的最新预测，2023年全球PC和平板电脑的出货量将降至4.031亿台，同比下降11.2%，也低于IDC全球季度个人计算设备跟踪报告，在2022年12月预测的4.295亿台。不过预计2024年将是一个恢复增长的年份，PC和平板电脑的出货量将比2023年增加3.6%，达到4.177亿台，超过疫情前的水平。IDC认为，由于消费者不再受到疫情的限制，PC需求订单已经完成，PC市场在2022年下半年发出了一个明确的信号：端点设备不再是重点，行业是调整优先级的时候，2023年需要考虑清理库存。IDC分析师指出，商业需求是预测中的一个亮点，因为混合办公模式和学校1:1配备方案扩大了整个潜在市场，Chromebook和平板电脑将从教育部署和更新中受益。此外，尽管苹果产品在最近几个季度保持了稳定而缓慢的增长，但苹果在商业客户中缺乏渗透，这可能导致其未来两年内落后于其他平台。(来源：中国半导体行业协会)

英特尔为其德国芯片厂寻求最高50亿欧元补贴。据知情人士透露，英特尔正寻求德国政府再提供40亿至50亿欧元的补贴，以推进其在德国马格德堡的一个芯片制造基地的建设。该项目总耗资已从最初拟定的170亿欧元，跃升至预计耗资300亿欧元。日前，英特尔已针对该芯片工厂的建设达成协议，并可获得68亿欧元(约合72亿美元)的政府补贴，这需要得到欧盟委员会的批准。但由于经济逆风，英特尔曾在一份声明中表示欧洲能源价格波动极大，通胀导致建筑成本飙升，并在去年年底推迟了该项目的开工，目前正在寻求更多的援助。据了解，英特尔去年宣布的欧洲扩张计划中还包括法国研究中心的建设及爱尔兰现有芯片工厂的扩建，目前仍在按计划进行。(来源：中国半导体行业协会)

Arm计划通过IPO融资至少80亿美元期望估值超过500亿美元。3月6日消息，据外媒报道，在英伟达400亿美元收购Arm的交易终止之后，软银就在为旗下的这一半导体技术提供商IPO做准备，推动这一全球半导体领域的关键厂商上市融资。对于Arm的IPO，外媒最新援引知情人士的透露报道称，Arm的目标可能是筹集至少80亿美元的资金，预计今年在美国上市。知情人士还透露，Arm预计会在4月下旬秘密提交IPO相关的文件，预计在今年年底上市，具体的IPO时间将由市场状况决定。外媒在报道中还提到，软银已经选定了4家投行，牵头这一近几年资本市场最受关注的IPO。知情人士也透露，高盛、摩根大通、巴克莱和瑞穗金融集团，预计将成为Arm IPO 的主承销商，但软银方面还未确定哪一家投行成为最主要的承销商。从知情人士透露的情况来看，Arm IPO 的准备工作，预

计会在未来几天于美国启动，估值范围尚未确定，但 Arm 方面希望超过 500 亿美元。（来源：中国半导体行业协会）

约 150 亿元，科技巨头建芯片设计中心减少对外依赖。据法新社报道，美国科技巨头苹果公司于近日宣布，将再斥资 10 亿欧元，扩大德国南部慕尼黑的微芯片设计中心阵容。报道称，这是苹果继 2021 年宣布投资 10 亿欧元，将慕尼黑打造为苹果“硅设计中心”欧洲总部后的新投资，将在未来 6 年分批投入。这意味着苹果在慕尼黑研发中心的投资将达 20 亿欧元（约合人民币 147.07 亿元）。苹果表示，这笔新投资将在现有慕尼黑研发中心基础上，成立 3 个新研发团队。此举是苹果策略的一环，开发 iPhone、iPad、MacBook 等自家产品的芯片，以降低对外部供应商的依赖。对于扩大慕尼黑的芯片设计中心，苹果硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 也表示，扩大设计中心将使他们在巴伐利亚（慕尼黑所在州）的 2000 多名工程师合作更紧密，致力于包括定制芯片设计、电源管理芯片和未来无线技术方面的突破性创新。（来源：中国半导体行业协会）

价值 230 亿美元！美政府去年 Q1 批准 192 份向中国公司出口的许可证。根据美国国会委员会周五公布的一份文件，拜登政府 2022 年第一季度批准了 192 份价值超过 230 亿美元的许可证，可以向美国贸易黑名单上的中国公司运送美国商品和技术。据路透社报道，图表显示，发放的 192 个许可证来自 2022 年 1 月至 3 月期间决定的 242 个许可证申请，其中 115 个许可证包含受控技术。另外，在 242 个申请中，有 19 个申请被拒绝，占申请总数的 8%，31 个未采取任何行动被退回。美国众议院外交事务委员会主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）周五公布了许可证数字，此前他在一次听证会上透露，2022 年第一季度，美国商务部“实体名单”上的公司的供应商获得了价值超过 230 亿美元的许可证。据悉，每一项许可证主要涉及低技术出口以及其他不构成重大国家安全问题的项目。出口商通常提交的许可证申请获得批准的可能性较高，许可证的有效期一般为四年，而且有相当一部分没有充分利用。根据此前麦考尔发布的数据，2020 年 11 月至 2021 年 4 月期间，华为的供应商获得了 113 个价值 610 亿美元的许可证，另外在 2021 年 10 月，中芯国际供应商获得了 188 个价值近 420 亿美元。（来源：中国半导体行业协会）

富士康计划投资 7 亿美元印度建新厂。据彭博社报道，知情人士称，苹果的合作伙伴富士康计划投资约 7 亿美元在印度新建一家工厂，以提高当地产量。富士康计划在靠近印度南部卡纳塔克邦首府班加罗尔机场的 300 英亩土地上建造 iPhone 零部件工厂。知情人士表示，该工厂还可能组装苹果的手机，富士康也可能利用该工厂为其新兴的电动汽车业务生产一些零部件。据知情人士透露，印度的新生产基地预计将创造约 10 万个就业岗位。此外知情人士表示，由于富士康正在敲定投资和项目细节，因此计划仍有可能发生变化。目前还不清楚该工厂是否代表新产能，或富士康从其中国工厂等其他地点转移的生产。根据此前消息，苹果不断推动供应链转移出中国，十几家苹果供应商已获得在印度扩厂的初步许可。富士康去年开始在泰米尔纳德邦的一个工厂生产最新一代的 iPhone，纬创和和硕在印度产能也有所增加，而捷普科技（Jabil Inc.）等供应商已开始在当地生产 AirPods 组件。除此之外，富士康布局印度制造消息不断。近日，继董事长刘扬伟拜会印度总理莫迪（Narendra Modi）后，刘扬伟一行人也与印度电子暨资讯科技部次长夏玛开会，双方就电子制造及半导体事业会谈。分析认为鸿海此行不仅涉及电子制造及半导体业务，也在考量是否能布局印度电动车（EV）市场。（来源：中国半导体行业协会）

美国芯片制造补贴 台积电比三星多 235 亿元。据韩媒报道，美国芯片制造补贴申请准则显示，给予的直接资金补助将占计划预期总支出 5% 至 15%，以此推算，三星有望获得 26 亿美元（约 179.8 亿人民币）补助，台积电的补助款可望上看 60 亿美元（约 414.92 亿人民币）。业界分析，美方补助对台积电等已保持技术领先且获利的厂商而言，堪称“象征意义大于实际意义”。韩国每日经济新闻英文版网站 Pulse News 报道，美国商务部根据芯

片与科学法而发布的资金机会通知（NOFO）显示，美方补助将透过直接发放资金、贷款以及贷款担保。直接发放资金通常占整体计划支出的5%至15%，贷款和贷款担保则无金额上限，前提是不超过整体支出的35%。以上述比率计算，三星在泰勒市投资170亿美元建厂，预计将获得8.5亿美元至26亿美元直接补助，若涵盖贷款和贷款担保，补助额达59.5亿美元。台积电砸400亿美元赴美设厂，获得的直接补助可能介于20亿美元至60亿美元。
(来源：中国半导体行业协会)

特斯拉与韩国L&F签署高镍正极材料供应协议 价值29亿美元。2月28日消息，据外媒报道，特斯拉与韩国电池材料制造商L&F签署了一份价值3.83万亿韩元(29.1亿美元)的高镍正极材料供应协议。L&F表示，其与特斯拉签署的合同为期两年，将从2024年1月1日开始到2025年12月31日结束。该公司指出，在合同期内，其材料的单位销售价格可能会随着锂价格的波动而上涨或者下降。周二，韩国投资证券(Korea Investment&Securities)分析师金正焕Kim Jung-hwan在一份报告中表示，他预计这笔交易将有助于特斯拉继续推进自己的电池供应链。
(来源：中国半导体行业协会)

亚马逊拟在马来西亚投资60亿美元建设云基础设施。据《华尔街日报》消息，亚马逊的云计算部门AWS于当地时间周三宣布，计划到2037年在马来西亚投资60亿美元，在这个东南亚国家推出云计算基础设施。AWS表示，计划在马来西亚建设一个基础设施区域，包括三个所谓的可用性区域，即数据中心集群。这些区域将在全球现有99个此类区域的基础上增加。亚马逊表示，此举将使客户能够在马来西亚安全地存储数据，并满足整个东南亚地区对云服务的需求。
(来源：中国半导体行业协会)

士兰微拟募资65亿元提升12英寸芯片、SiC功率器件等产能。士兰微向特定对象发行股票募集资金总额不超过65亿元，投资于年产36万片12英寸芯片生产线项目等。大半导体产业网消息，士兰微3月1日披露了其A股股票募集说明书，士兰微本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过65亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目(一期)，以及补充流动资金。士兰微表示，受国家政策拉动等多方面因素影响，目前国内芯片市场需求较为强劲，公司各生产线的产能处于偏紧状态。对此，公司正在加快年产36万片12英寸芯片、SiC功率器件与汽车半导体封装等产线建设，并积极调整产品结构，加快产品在大客户端的上量。
(来源：大半导体产业网)

金山软件、小米等拟成立集成电路相关领域股权投资基金。金山软件及其附属公司武汉金山、小米等投资者订立合伙协议，成立集成电路相关领域投资基金。大半导体产业网消息，金山软件3月2日发布晚间公告称，其附属公司武汉金山、小米北京、小米武汉与其他投资者订立合伙协议，内容有关成立该基金，预期认缴出资额为人民币100亿元。该基金成立后，其将不会成为金山软件的附属公司，且不纳入集团合并报表范围。公告显示，该基金将主要从事股权投资或准股权投资，或对非上市公司进行投资相关活动，该等公司主要着重于集成电路，以及相关上游及下游领域(涵盖新一代资讯科技、智能制造、新材料、人工智能、显示器及显示装置、汽车电子，以及有关移动终端消费品及智能装置的上游及下游应用及供应链)。
(来源：大半导体产业网)

5. 风险提示

宏观不确定性，疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

| 类别 | 说明 | 评级 | 体系 |
|--------|--------------------------------|------|------------------|
| 股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅 | 买入 | 预期股价相对收益 20%以上 |
| | | 增持 | 预期股价相对收益 10%-20% |
| | | 持有 | 预期股价相对收益-10%-10% |
| | | 卖出 | 预期股价相对收益-10%以下 |
| 行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上 |
| | | 中性 | 预期行业指数涨幅-5%-5% |
| | | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅-5%以下 |

天风证券研究

| 北京 | 海口 | 上海 | 深圳 |
|--|--|---|--|
| 北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com | 海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：571012 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com | 上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com | 深圳市福田区益田路 5033 号 平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com |